# ①ポスト5G情報通信システムの開発



## (b) 伝送路

(b1) 光伝送システムの高速化技術の開発

ポスト5G情報通信システムにおけるテラビット光伝送システムの研究開発

(b2) 光伝送用DSPの高速化技術の開発

テラビット級光伝送用DSP実装基盤技術の研究開発

(b3) 微細化の進展に対応した高速不揮発性メモリ技術の開発

ポスト5G情報通信システムのための革新的不揮発性メモリおよび光伝送技術の研究開発

(b4) 固定無線伝送システム大容量化技術の開発

クロスホール向け大容量固定無線伝送システムの開発

(b5) バス型伝送高度化技術の開発

バス型海底ケーブルネットワークのコネクティビティの向上の研究開発

(b6) 超高速光リンク技術の開発

ポスト5G情報通信システム向け200Gbps/λ光デバイスの研究開発

(b7) 光スイッチ高度化技術の開発

次世代型の高解像度LCOSによる波長選択スイッチの研究開発

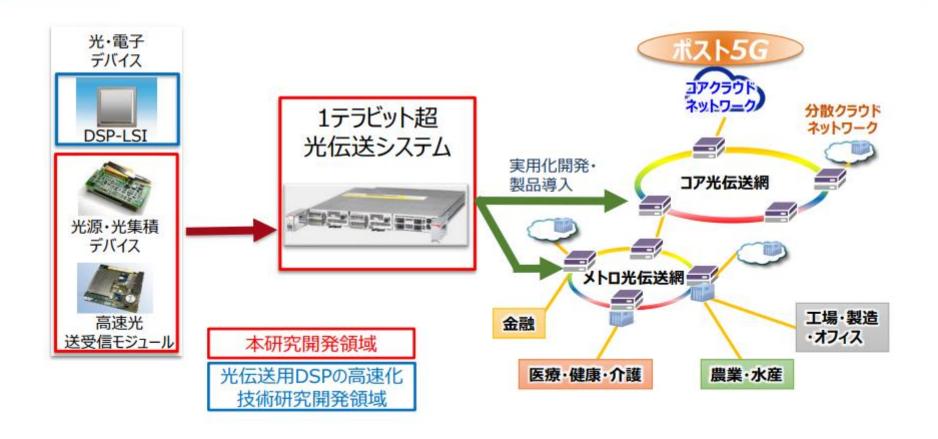
# ポスト5G情報通信システムにおけるテラビット光伝送システムの研究開発

### 実施者

### 富士通株式会社

### 概要

ポスト5G世代のネットワークを支える<u>大容量・小型・低消費電力の毎秒1テラビット(1兆ビット)超</u>光伝送システムを要素部品レベルから一気通買で研究開発することにより、世界に先駆けて実現します。 本技術により、ポスト5G情報通信ネットワークによる新たなサービス・アプリケーションがもたらす経済効果の 創出とともに、情報通信ネットワークのカーボンニュートラル化を推進し、持続可能な社会の実現に貢献します。



# テラビット級光伝送用DSP実装基盤技術の研究開発

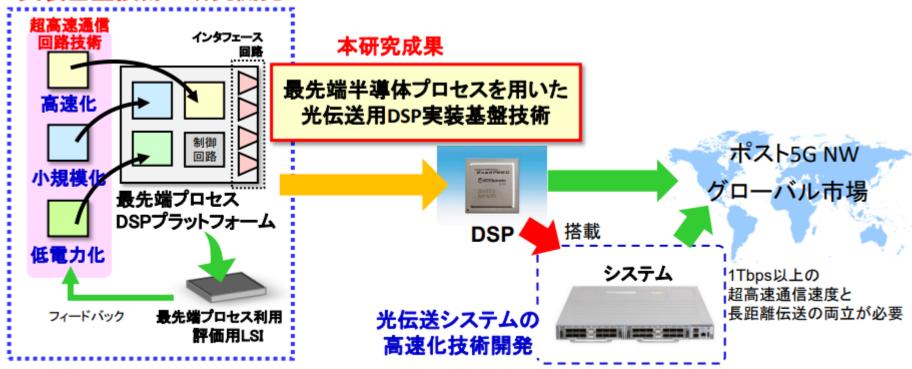
### 実施者

NTTエレクトロニクス株式会社、日本電気株式会社、富士通株式会社

概要

ポスト5Gでは、これまでの10倍以上の通信容量への対応が求められます。本研究開発では、長年培った 超高速・低電力通信用DSP開発の経験やノウハウを基に、<u>超高速・小型・低電力通信装置を可能とする</u> キーデバイスである、<u>テラビット級光伝送用DSP</u>を実現する、<u>最先端半導体プロセス</u>を用いた実装基盤技 術を確立します。

## テラビット級光伝送用DSP 実装基盤技術の研究開発



## ポスト5G情報通信システムのための革新的不揮発性メモリおよび光伝送技術の研究開発

#### 実施者

国立研究開発法人産業技術総合研究所、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社

概要

ポスト5Gにおいて高効率且つ柔軟な情報通信・情報処理システムを構築するための基盤技術として、様々なロジックチップに搭載可能なキャッシュメモリ用の高速不揮発性メモリ技術を開発する。また、同メモリ技術も活用しながら、ポスト5G向けにさまざまなデジタル信号処理技術を用いてソフトウエア上で自由に方式変更可能な光伝送技術(ソフトウエア光伝送)およびクラウド上で伝送方式を最適配分するオーケストレーション技術を開発する。これらの開発技術は、ローカル5Gチップおよびイメージセンサー、ポスト5Gの仮想化システム用光伝送機器などへの事業展開が想定される。

#### ポスト5Gでは

- ・ユースケースごとに異なるネットワーク運用 必要な時に必要な性能を必要な場所に提供 クラウドネイティブなネットワークを可能とするロジック〈開発項目1〉
- ・ビーク時において4Gの1,000倍ものデータ転送容量が必要 <u>柔軟かつ大容量な光伝送システム(開発項目2)</u>





(出典)支持20年 投資金銭銀運用金銭金銭出仕まパノル運搬シフラル乗員会報告

#### ポスト5G級の広帯域・低遅延光信号をソフトウエア上で柔軟に転送・処理可能な次世代ロジックの実現



#### 事業項目

#### コアコンビテンス

事業項目1 ポスト5G向けSoC用不揮発性メモリ

300mm後 工程ファブ ( TIA-SCR)



SRAM代替用 電圧駆動 MRAM



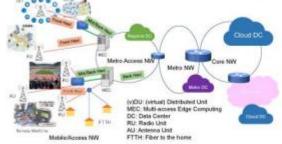
#### 事業項目2 ポスト5G向けソフトウエア光伝送方式

光伝送評価 システム



仮想化光パス ネットワーク テストベッド





#### ポスト5Gネットワーク構成概念図

- 無線信号をEthernet信号に変換するディストリビューテッド ユニットやMECが適材適所に配置され、無線信号をその まま伝送するフロントホールと変換後のミッド/バックホー ルが混在する
- モバイルサービスやネットワーク機能は仮想化されvDU、 MEC、データセンターにおいてソフトウエア上で処理される

## クロスホール向け大容量固定無線伝送システムの開発

### 実施者

日本電気株式会社

概要

5Gシステム高度化や基地局設置数増加に伴い、基地局を収容する通信回線:クロスホール(バックホール/フロントホール)の大容量化や短期間での基地局設置を可能とする伝送路技術が必要とされる。そこで、光回線並みの最大25Gbps以上の伝送容量と柔軟かつ高品質な通信回線の実現に向けて、高システムゲインを獲得する無線性能向上と高い通信品質を有する無線伝送大容量化による固定無線伝送システムを開発する。

### 無線伝送容量拡大

無線伝送距離拡張

無線信頼性向上

### ①無線性能向上開発

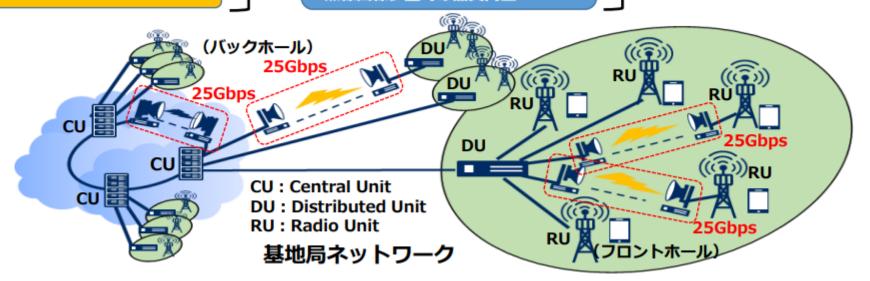
- ・送信信号の高出力化
- ・無線システム利得向上



- ・無線伝送容量の拡大
- ・無線回線多重時の品質向上



クロスホール向け 大容量固定無線 伝送システムを 開発し事業化



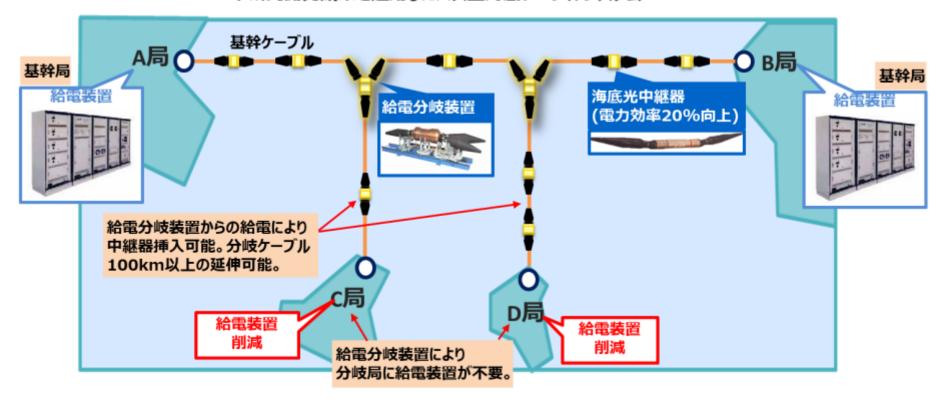
# バス型海底ケーブルネットワークのコネクティビティの向上の研究開発

実施者 日本電気株式会社

概要

バス型海底ケーブルシステムによる島しょ部への効率的な5Gシステム構築に向けて、<u>基幹/分岐ケーブル間の給電分岐装置</u>および、<u>海底光中継器における電力消費量を低減する技術</u>を開発し、基幹局からシステム全体への電力供給の効率化を図る。これらの技術開発により、バス型光海底ケーブルの接続性の向上、柔軟なシステム設計の実現を図る。

### 本研究開発成果を適用したバス型海底ケーブルシステム



# ポスト5G情報通信システム向け200Gbps/λ光デバイスの研究開発

### 実施者

### 三菱電機株式会社

### 概要

ポスト5G時代には基地局収容回線(モバイルフロントホール)のさらなる伝送容量拡大が求められる。ま た、自動運転、遠隔医療、スマート工場等のミッションクリティカルアプリケーションの実現にあたっては高性能 なMECの活用が期待されている。これらモバイルフロントホールやMECに要求される光通信伝送需要を満た すため、1波長あたり200Gbpsで伝送可能な電界吸収型光変調器集積レーザダイオード(EML)チップ を開発する。

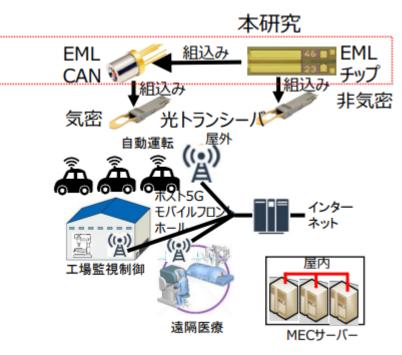
当社

製品

## ■本研究の範囲

#### 量産品 モバイルエッジ 光トランシーバ --- コンピューティ ング(MEC) ポスト5G 実装 ネットワークへ 形態 組込 の社会実装 モバイル フロントホール 200Gbps MLチップ開発 本計画 伝送速度[Gbps/波長] ≥200 On/Off比[dB] ≥5.5 本研究の範囲 伝送距離[km] ≥1

## ■社会実装のイメージ



# 次世代型の高解像度LCOSによる波長選択スイッチの研究開発

### 実施者

株式会社JVCケンウッド、エピフォトニクス株式会社

概要

ポスト5G時代にはあらゆる場所で発生する多種多様・膨大なデータを超低遅延、超高速、かつ低消費電力で伝送できる光通信ネットワークが求められる。そのような柔軟なネットワーク構築を可能とする光多重・分岐挿入装置(ROADM)実現には高度な波長選択スイッチ(WSS)が必要であり、700万画素以上の超高解像度LCOS とこれを搭載した大規模WSS(4並列1x24型および8x32型)を開発する。

